

Title (en)

Packaging container containing a power semiconductor module

Title (de)

Verpackungsbehältnis mit Leistungshalbleitermodul

Title (fr)

Conteneur d'emballage contenant un module semiconducteur de puissance

Publication

EP 1544130 A1 20050622 (DE)

Application

EP 04025144 A 20041022

Priority

DE 10358843 A 20031216

Abstract (en)

The device has at least one molded body (100a,100b) with a wall and a preferably fully closed cover surface (120a,b), supporting edges (112) or surfaces, whereby the module rests on wall sections and contact with the cover surface is prevented by the supporting edges or surfaces. The cover surface has at least one support (122) that narrows as it extends into the molded body and into an opening in the module (200) to prevent contact between the module and covering surface.

Abstract (de)

Die Erfindung beschreibt ein Verpackungsbehältnis für Leistungshalbleitermodule zu deren inner- und / oder außerbetrieblichen Transport. Diese besteht aus einem Formkörper (100), welcher eine Wandung sowie eine Deckfläche aufweist. Entweder weisen hierbei gegenüberliegenden Wandungsabschnitte (110) eine Abstützkante (112) auf oder an mindestens drei Stellen der Wandung ist eine Abstützfläche angeordnet. Das Leistungshalbleitermodul (200) liegt an den Wandungsabschnitten (110) an, dadurch ist eine Berührung des Leistungshalbleitermoduls (200) mit der Deckfläche (120) des Formkörpers (100) verhindert. Alternativ weist der Formkörpers (100) eine Stütze (122) auf, die sich von der Deckfläche (120) in das Innere des Formkörpers (100) erstreckt, sich von der Deckfläche (120) aus ins Innere verjüngt und sich teilweise in eine Aussparung (214) des Leistungshalbleitermoduls (200) hinein erstreckt. <IMAGE>

IPC 1-7

B65D 81/02

IPC 8 full level

B65D 25/10 (2006.01); **B65D 81/02** (2006.01); **H01L 21/673** (2006.01)

CPC (source: EP)

B65D 25/106 (2013.01); **B65D 81/025** (2013.01)

Citation (applicant)

- DE 3909898 C2 19911114
- DE 10306643 A1 20040826 - SEMIKRON ELEKTRONIK GMBH [DE]
- DE 10320186 A1 20041202 - SEMIKRON ELEKTRONIK GMBH [DE]
- CA 2372480 A1 20030815 - SMITH FORREST [US]
- JP H09290891 A 19971111 - SHINETSU POLYMER CO

Citation (search report)

- [XY] CA 2372480 A1 20030815 - SMITH FORREST [US]
- [A] US 5518120 A 19960521 - AHLBOM BRADLEY G [US], et al
- [XY] PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1998, no. 03 27 February 1998 (1998-02-27)

Cited by

EP1783831A3

Designated contracting state (EPC)

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LI LU MC NL PL PT RO SE SI SK TR

DOCDB simple family (publication)

EP 1544130 A1 20050622; **EP 1544130 B1 20100414**; AT E464247 T1 20100415; DE 10358843 B3 20050324; DE 502004011027 D1 20100527; DK 1544130 T3 20100712; ES 2341106 T3 20100615

DOCDB simple family (application)

EP 04025144 A 20041022; AT 04025144 T 20041022; DE 10358843 A 20031216; DE 502004011027 T 20041022; DK 04025144 T 20041022; ES 04025144 T 20041022